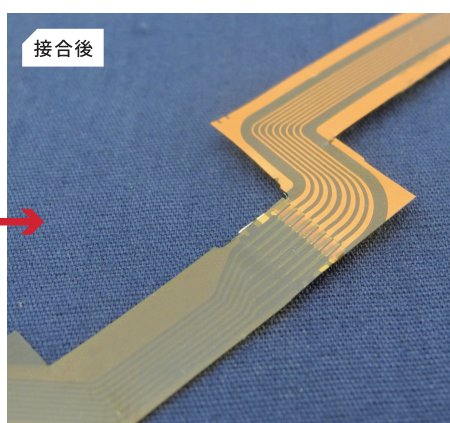
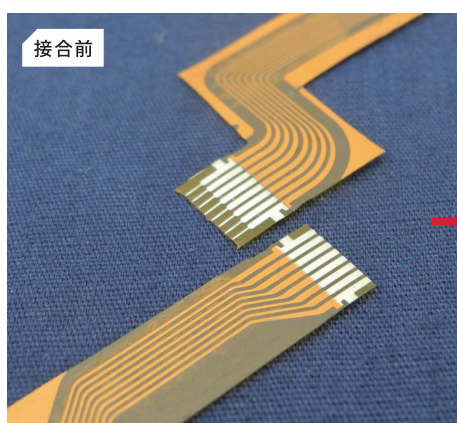




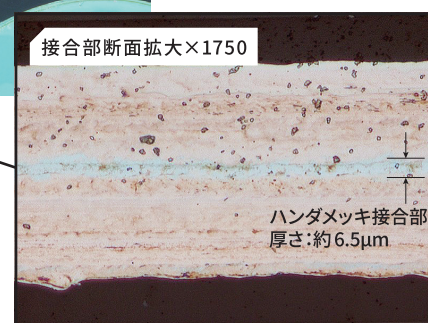
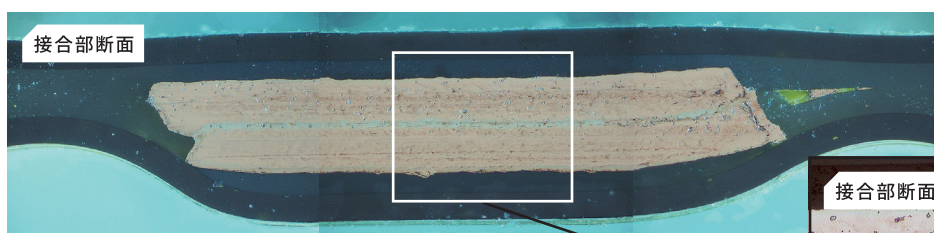
Application

Bonding ボンディング

FPCのクリップ合金 音波接合



- 銅回路 厚さ:約50 μ m
- ハンダメッキ 厚さ:10 μ m



Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0036A4-2020061001